

合肥晶合集成电路股份有限公司

“提质增效重回报” 2025 年度评估报告

暨 2026 年度行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司内在价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司于 2025 年 4 月 21 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。为持续夯实高质量发展根基，增强价值创造能力，公司在 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施的基础上，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2026 年 3 月 26 日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现将 2025 年全年的主要工作成果暨 2026 年度行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

2025 年，公司围绕行动方案的战略方向，积极聚焦主营业务，持续加大研发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业认可度，公司订单充足，产能利用率维持在高位，经营管理效率和运营水平不断提升。公司全年实现营业收入 1,088,544.93 万元，同比增长 17.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,420.44 万元，较上年同期增长 32.16%；实现经营活动产生的现金流量净额 384,291.99 万元，较上年同期增加 108,178.86 万元。2025 年公司综合毛利率为 25.52%，整体盈利能力保持稳健。

1、重视质量管理，强化产品质量

公司深知产品质量是公司稳健经营与可持续发展的根基。为此，公司建立了一套覆盖全维度的闭环质量管理体系，从源头到终端实施系统管控，并持续完善问题处理与技术迭代机制，确保产品的稳定性与可靠性。2025 年度，公司主要

量产平台良率均稳定在较高水平，为客户提供高性能、高良率、高可靠的晶圆代工服务，产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，与众多客户建立了长期、紧密的战略合作关系。同时，公司通过定期开展质量主题宣传与培训活动，深化全员质量意识，筑牢质量管理文化根基，推动产品与服务品质的全面提升。2026年度，公司将继续以技术创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，进一步优化产品质量与工艺能力，丰富技术储备，并有序引入先进的生产设备和技术，不断加强质量管控体系建设，致力于为客户提供更稳定、更可靠的晶圆制造服务。

2、优化产品结构，丰富产品线

公司不断推出有市场竞争力的新产品，优化产品结构。2025年度，公司实现主营业务收入1,038,830.23万元，从制程节点分类看，40nm、55nm、90nm、110nm、150nm占主营业务收入的比例分别为0.05%、10.71%、42.95%、27.16%、19.13%；从应用产品分类看，DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU占主营业务收入的比例分别为58.06%、22.64%、12.16%、3.87%、2.82%，其中CIS和PMIC产品营收占比不断提升。

2026年度，公司将持续丰富自身产品结构及强化自身技术能力，扩大应用领域及开发高阶产品，提升产品竞争优势及多元化程度。其中，在OLED显示驱动芯片代工领域，公司28nm OLED产品持续验证中，40nm高压OLED显示驱动芯片、110nm Micro OLED均已实现批量生产；在微控制器芯片代工领域，公司55nm全流程堆栈式CIS芯片已实现批量生产；在电源管理芯片代工领域，公司已开展AI服务器相关电源管理芯片研发，其中90nm BCD产品持续验证中；在逻辑芯片代工领域，公司55nm逻辑产品已实现批量生产，28nm逻辑工艺平台已完成开发。在车用芯片制造能力建设上，公司已实现首颗车规MCU产品风险量产，并成功导入国内头部车厂供应链。未来，公司平台及产品结构将日益丰富，为客户提供更加丰富的产品解决方案。

3、加大研发投入，提升核心竞争力

公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入，以保证技术和产品持续创新，提高产品市场竞争优势。2025年，公司研发投入为145,340.02万元，较上年增长13.20%，占营业收入的比例为13.35%；公司新增专利416个，其中发明

专利 317 个，截至 2025 年末公司累计获得专利 1,374 个。2025 年，公司 28nm 逻辑工艺平台完成开发，40nm 高压 OLED 显示驱动芯片、55nm 全流程堆栈式 CIS 芯片、55nm 逻辑芯片、110nm Micro OLED 芯片均实现批量生产。

公司聚焦核心技术，紧跟传统领域与新兴市场的发展趋势，以客户需求为导向，规划和研发更丰富的工艺平台，推进技术迭代升级。2026 年，公司在研发方面会持续投入资源，以加强公司核心技术能力，全面提升产品组合的技术竞争力。未来几年，公司重点投入的研发项目进展与达成目标如下：

序号	项目名称	研发进展	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	22nm 工艺技术 研发项目	技术 开发 阶段	完成平台开发，包括全套低、中、高压器件，提供低功耗，高效能的元件方案供客户设计，并实现批量生产	国际 主流	时序控制，WiFi、射频、OLED 驱动、图像处理芯片
2	28nm 高效能 逻辑工艺平 台	技术 开发 阶段	完成平台开发，包括全套低、中、高压器件，提供低功耗，高效能的元件方案供客户设计，并实现批量生产	国际 主流	时序控制，WiFi、射频、OLED 驱动、图像处理芯片、存储运算芯片
3	28nm 逻辑及 OLED 芯片 工艺平台	产 品 验 证 阶 段	完成平台开发，包括全套低、中、高压器件，提供高容量 SRAM，降低功耗，适应各种高端显示技术需求	国际 主流	视频 SoC、图像处理 (ISP)、信号传输及视频桥接芯片、时序控制芯片、内存控制器、FPGA、CPU、高阶智能手机 OLED 屏
4	55nm 高阶显 示驱动芯片 技术平台	技术 开发 阶段	完成平台开发，提供高密度、高可靠性 SRAM 及 RRAM，适应各种高端显示技术需求	国际 主流	智能手机 OLED 屏、笔记本电脑 OLED 屏
5	55nm 增强型 逻辑芯片技 术平台	工 艺 制 程 验 证 阶 段	完成平台开发，包括全套低、高压器件，提供高容量 SRAM，导入客户并实现批量生产。	国内 主流	时序控制芯片、高速传输、解码译码、无线耳机
6	90nm 新型显 示驱动芯片 工艺平台	技术 开发 阶段	开发高压组件，提高驱动能力，导入客户并实现批量生产	国际 主流	电子标签、电子纸等电子产品
7	110nm 高阶 显示驱动芯 片工艺平台	工 艺 制 程 验 证 阶 段	完成平台开发，满足车规、超低漏电等多种工艺需求，实现产品批量生产	国际 主流	VR 眼镜/AR 眼镜/抬头显示/辅助显示/车用 LCD 面板/仪表板/笔记本电脑
8	55nm 高效能 CMOS 图像 传感器平台	技术 开发 阶段	完成 55 纳米高效能 CMOS 图像传感器平台开发，并实现批量生产	国内 领先	智能手机、游戏娱乐等

9	90nm 高阶 CMOS 图像传感器技术平台	量产阶段	完成 90 纳米图像传感器工艺制程验证，进行车规级可靠性验证，导入客户，并实现批量生产	国内主流	智能手机、安防、无人机、游戏娱乐、工业自动化等
10	90nm 高效能 CMOS 图像传感器平台	工艺制程验证阶段	完成 90 纳米高效能 CMOS 图像传感器平台开发，并实现批量生产	国内主流	高端安防，车载摄像头等
11	110nm 高阶微控制器平台	风险量产阶段	完成平台开发，通过车规级可靠性验证，导入客户，实现批量生产。	国内主流	智能家电、办公设备及 PC/笔记本电源、视频转接口芯片等
12	90nm BCD 电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发及 AEC-Q100 车规可靠性测试，导入客户实现批量生产	国内主流	接口芯片、快充协议芯片、手机电源管理芯片、AI 服务器等
13	110nm 高压电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发，降低器件导通电阻，提高器件耐压，导入客户并实现批量生产	国内主流	快充协议芯片、音频功放、消费电子电源管理芯片、储能领域电池管理（BMS）
14	150nm 电源管理芯片技术平台	量产阶段	完成平台开发，提高器件耐压，达到客户器件规格需求，提升产品良率，实现产品批量生产	国内主流	负载开关、DC-DC、AC-DC 转换、LED 照明、电机驱动、LDO 各式电源驱动、快充协议芯片、工控（手持电动工具充电等）、手机/移动设备等低端消费电子、LED Driver、TV PMIC 等
15	功率半导体技术平台	量产阶段	完成功率半导体工艺平台开发，降低器件导通电阻并提高器件耐压，导入客户并实现批量生产	国内主流	工业电机控制、车用电机等
16	光罩研发项目	结案	导入客户实现批量生产	国内主流	芯片掩模版

4、加强募投管理，推进募投项目建设

2023 年 5 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金净额为 97.24 亿元。截至 2025 年末，募集资金累计投入 90.10 亿元，累计投入进度 92.67%。截至 2025 年底，公司募投项目“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”的募集资金已按规定用途使用完毕并结项；另外，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，同意将募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台

研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”、“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本方案披露日，公司所有首次公开发行募投项目均已结项，公司所有募集资金专户均已办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

二、优化运营管理，实现降本增效

1、加强生产管理，强化资源整合

2025 年，公司通过工艺优化等手段提升生产效率，降低生产成本，实现降本增效，提升公司核心竞争力。公司智能生产线配备了先进的智能制造运营管理系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的产品品质。公司进一步加强将人工智能技术全面导入研发、营运等核心环节，通过 AI 驱动工艺优化、智能调参与自动检测，显著提升生产效率与质量管理水平。同时，公司生产集中在同一园区内，可有效减少重复建设，自动化晶圆传送系统贯穿整个厂区，显著提升投资效益并优化产能调度。此外，公司积极推动关键原辅材料和设备的国产化，且本地产业链配套较为齐全，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，产品成本更具竞争力。2026 年，公司将持续提升精细化管理水平，加强内部生产管理与资源整合，持续优化和提升生产运营效率。

2、提高资金效率，重视应收账款管理

由于公司所处半导体设备行业具有资金密集性的特征，产品技术升级快，研发投入规模大、周期长，且通常需早于市场应用进行布局。为此，公司始终秉持审慎财务原则，科学规划资金使用，确保研发投入与产品布局具备一定的前瞻性，以匹配客户需求。2025 年，公司通过优化库存、加快新产品在客户端的验收、加快回款等举措，持续提高资金使用效率。同时，公司严格执行应收账款相关管理制度，完善内部控制，定期对客户信用重新评估，并积极采取多种举措促进应收账款回笼，目前公司主要客户的应收账款状态良好。2026 年公司将持续提高

资金使用效率并优化应收账款管控措施，进一步提高运营效率、增加经营活动现金流入，为公司持续健康发展提供稳健的财务支撑。

3、重视人才队伍建设，构建义利共生的人才战略

公司始终将人才视为发展的核心资源，持续加强人才队伍建设，积极引进与培养各类专业人才。截至 2025 年底，公司拥有研发技术人员 1,976 名，占员工总人数比例为 34.61%。研发人员中硕士及以上学历占比为 68.98%，为公司持续创新与高质量发展提供了坚实的人才保障。公司高度重视员工能力提升，2025 年通过内部培训、在线学习平台、外派研修等方式开展包括专业类、管理类、潜能开发类等特色培训活动，为员工提供学习资源，促进员工与公司共同发展。2026 年，公司将继续引进和培养各方面的人才，吸纳全球高端人才，优化人才结构。同时，公司将进一步优化现有培训体系，创新培训形式，加强团队分享学习，形成有效的人才培养和成长机制，发展高效协同的企业文化。

公司通过员工持股平台、股权激励、绩效奖励及员工补充养老计划等措施持续加强团队稳定性。2025 年，公司实施了新一期限制性股票激励计划，并完成该激励计划的首次及预留授予，以人民币 12.00 元/股的授予价格向 1,000 余名核心员工授予 6,208.85 万股限制性股票，约占公司总股本的 3.09%，该激励方案制定了与公司经营发展相适应的公司层面和个人层面的绩效考核指标并严格执行，进一步提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。此外，公司正式推出覆盖全员的员工补充养老计划，通过完善退休后待遇保障，鼓励员工长期服务企业，实现个人与公司共同成长。未来公司将持续健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

三、强化公司治理体系，构筑坚实发展基石

1、完善公司治理体系，坚持规范运作

2025 年，为适应新《公司法》及中国证监会相关配套规则的要求，进一步提升公司治理效能，公司召开股东会审议通过了《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司依法取消监事会，《监事会议事规则》同步废止，监事会全部法定职权由董事会审计委员会承接。同时，公司通过职工

代表大会民主选举程序选出一名职工代表董事，职工代表董事的增设进一步完善了董事会多元化治理结构，打通了职工参与公司重大决策的渠道，提升了决策的科学性与民意基础。此外，公司持续完善内部控制体系制度，紧密跟踪相关法律法规的变化，报告期内完成了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及专门委员会工作细则等 31 项治理制度的制定、修订工作，进一步完善公司法人治理和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2026 年，公司将持续加强内控管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及监管部门的配套规定，进一步对公司治理结构及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度进行修订、制订，推进治理架构优化与规范运作升级，强化“关键少数”契约约束、完善风险导向激励机制，进一步夯实公司持续健康发展的治理根基。

2、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制

2025 年，公司高度重视大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职能力建设与合规意识提升。通过保持常态化的有效沟通，及时传达最新监管政策与法规动态，并积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类专题培训，持续强化其规范履职意识和风险管理能力，确保其行为符合监管要求与公司治理规范。2026 年，公司将继续深化与“关键少数”的沟通机制，积极组织参与中国证监会、上海证券交易所等监管机构开展的专项培训，定期开展法律法规与业务规则学习，不断增强其合规意识和履职能力，确保其及时、准确理解并落实监管政策与公司治理要求。

在激励与约束方面，2026 年公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司执行董事、高级管理人员进行绩效考评。绩效薪酬结构将严格遵循监管要求，构建以风险共担、长期导向为核心的薪酬分配体系。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督相关激励考核方案的制定与实施。若发生财务造假、重大内部控制缺陷或业绩严重偏离预期等情形，公司将依法依规对已发放的绩效薪酬予以追索。绩效薪酬将以经审计的财务数据和内控评价结果为依据，坚决防范短期行为，进一步强化管理层与股东利益共享、风险共担的机制，强化“关键少数”对可持续发展的责任意识与担当，切实推动公司长期稳定发展。

3、为独董履职创造良好环境，强化合规履行职责

2025年，公司严格遵循监管部门对独立董事履职的各项规定与要求，及时修订了《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》。公司积极保障独立董事履职行权，通过组织其出席股东会、董事会会议、参加业绩说明会等常态化沟通机制，确保独立董事深度参与公司治理与监督重要环节。独立董事凭借其专业优势与独立判断能力，积极参与董事会讨论并对关联交易等议案提出专业意见，独立董事的作用得到充分发挥，为公司科学决策提供了重要参考，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。2026年，公司将定期评估独立董事的独立性，并持续完善独立董事履职保障与重大事项预沟通机制，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

四、提升 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司董事会深知积极履行社会责任对企业长期价值创造的重要性，持续引导公司践行可持续经营，注重生态环境保护，深化利益相关方沟通，并以此驱动管理水平的系统提升。2025年，公司进一步完善了 ESG 管治架构，将“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订了相关制度，从制度层面保障了公司 ESG 工作的有效实施。截至目前，公司已连续3年公开披露可持续发展报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。公司参考国际、国内可持续发展相关标准，开展可持续发展实质性议题识别与评估，判定 ESG 风险，努力落实环保减排及资源再利用方针，营造包容开放的职场环境，完善内部控制及风险管理机制，充分将 ESG 及可持续发展融入常态化工作与管理。

2026年，公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

五、提高信息披露水平，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2025年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真做好信息披露工作，

并成功在上海证券交易所沪市上市公司 2024 至 2025 年度信息披露工作评价中荣获 A 级评级。

公司通过投资者热线电话、邮箱、业绩说明会等多种形式持续强化与投资者的有效沟通。在定期报告发布后，公司通过上证路演中心召开业绩说明会，以网络互动的形式解读了公司业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。同时，公司报告期内组织回答“上证 e 互动”问题 13 项、接待机构投资者线上及现场调研 3 场、接听并记录投资者热线来电 200 余次，这些举措有效地实现了公司与资本市场的良性互动，极大程度地增进了投资者对公司的深入了解和充分信任，从而为公司的长期稳健发展构筑了坚实的基础。除此之外，全年召开的 3 场股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司于 2025 年中期启动运用“一键通”智能提醒服务，通过短信主动推送会议通知、投票指引，精准传达至全体登记在册的中小股东，有效提升股东参与度。

2026 年度，公司将在严守披露底线的同时，致力于持续提升信息披露质量，强化披露内容的有效性，使所披露信息切实贴合投资者与市场需求，为各方决策提供有力支撑。同时，公司将召开不少于 3 次业绩说明会，并通过视频或文字直播、定期报告、企业社会责任报告等形式，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况；公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。

六、重视投资者回报，维护投资者利益

公司重视市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制订公司《市值管理制度》。公司将持续完善市值管理机制，在依法合规、尊重市场规律的前提下，综合运用公司治理优化、信息披露透明、投资者关系管理等多种方式，推动公司内在价值与市场价值的长期协同。公司始终重视股东回报，致力于通过稳健经营与可持续发展，切实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，维护资本市场对公司价值的合理认可。

1、股东分红回报规划

公司坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。在符合利润分配条件的前提下，结合公司实际经营情况及未来发展规划，积极制定

合理的利润分配方案，与投资者共享公司的发展成果。2025年6月19日，公司完成了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共派发现金红利总额为1.94亿元（含税）。

由于公司所处的晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，公司在综合考虑所处行业情况和特点、发展阶段、自身经营模式、未来研发投入需求以及产能扩充等长期战略规划后，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究讨论，拟定公司2025年度不进行利润分配，该方案尚需提交股东会审议。

2026年，公司将结合经营需要以及发展战略等实际情况，平衡好公司可持续发展与投资者回报之间的关系，落实打造可持续发展的股东价值回报机制，根据自身盈利水平、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，制定合理的利润分配方案，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，优先选择现金分红，并积极研究增加分红频率、优化分红节奏，切实回报股东，提升股东的获得感。

2、稳定股价预案

为保持公司上市后股价稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员承诺自公司首次公开发行上市之日起三年（36个月）内，如非因不可抗力因素所致，在公司A股股票收盘价格出现连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值的条件满足时，将依据法律法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响公司上市条件的前提下实施稳定股价的措施。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年3月26日